

특1993-0018736

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ H01L 27/146	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특1993-0018736 1993년09월22일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특1993-0001669 1993년02월05일	
(30) 우선권주장 (71) 출원인	92-54322 1992년02월05일 일본(JP) 가부시키가이샤 한도오파이 에너루기 겐큐쇼	아마자끼 순페이
(72) 발명자	일본국 가나가와켄 아쓰기시 하세 398 아마자끼 순페이	
(74) 대리인	일본국 도쿄도 세타가야구 7조메-키타가라스야마 21-21 마세 아키라 일본국 아이치현 오카자키시 미카조 3-75-3 히로키 마사야키 일본국 가나가와켄 이세하라시 시라네 533-10 다케무라 아스히코 일본국 가나가와켄 아쓰기시 하세 931-1 플랫 아쓰기 208 장홍동 일본국 가나가와켄 아마토시 후카미다이 1-10-15 파레스 미야가미 302 우오치 히데키 일본국 가나가와켄 아쓰기시 하세 931-1 플랫 아쓰기 105 황익만	

심사청구 : 있음

(54) 반도체장치와 그 제작방법

요약

본 발명은 액티브 매트릭스형 전기광학장치, 특히 액티브 매트릭스형 전기광학장치들에 이용될 수 있고, 명확한 스위칭 특성을 갖는 절연게이트형 전계효과 트랜지스터의 구조 및 그 제작방법에 관한 것으로, 본 발명에서는 게이트 전극의 표면에 양극산화에 의한 절연막층을 설치하는 것으로, 채널길이들 게이트 전극의 채널-장방향을 길이 보다도 길게 되어, 채널영역의 양측부에 게이트 전극에 의한 전계가 걸리지 않는, 혹은 매우 약한 전계가 걸리는 오프셋 영역을 설치하거나, 혹은 같은 방법에 의해 동일한 효과를 갖는 비 결정성의 불순물 반도체 영역을 설치할 수 있어, 역바이어스시의 리크전류를 줄일 수 있고, 그 결과 종래에 꼭 필요했던 전하유지 용량이 불필요하게 되어, 종래에 비해 개구율을 크게 향상시킬 수 있고, 보다 양호한 표시품질 얻을 수 있는 반도체장치 및 그 제작방법이다.

도표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체장치와 그 제작방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 반도체장치의 구조도.

제6도는 실시예 1에 있어서 액티브 매트릭스형 액정 전기광학장치의 회로도.

제9도는 본 발명에 의한 TFT의 특성에 및 그 동작원리를 나타내는 도면.

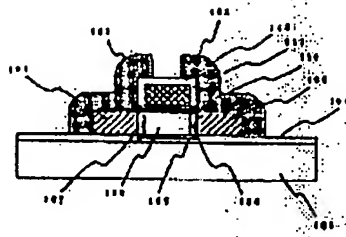
본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

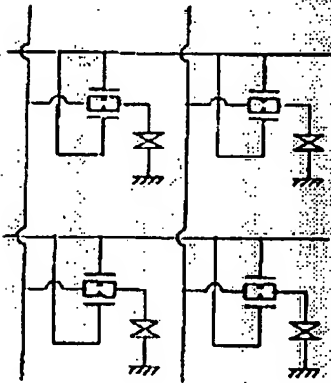
- 청구항 1. 절연기판상에 적어도 반도체층, 절연막층 및 도체층을 갖는 절연게이트형 전계효과 트랜지스터에 있어서 채널길이 게이트 전극의 채널 장방향의 길이 보다도 긴 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 2. 제1항에 있어서, 채널의 길이는 게이트 전극의 채널 장방향의 길이 보다도 게이트 전극 표면에서 형성된 산화층을 두께의 제2배 정도 긴 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 3. 절연기판상에 적어도 반도체층, 절연막층 및 도체층을 갖는 절연 게이트형 전계효과 트랜지스터의 제작방법에 있어서, 반도체층 및 게이트 절연막층을 형성한 후에 양극산화 가능한 재료에 의해 게이트 전극부를 형성한 후에, 상기 반도체층에 p형화 또는 n형화시키는 불순물 이온을 주입하여 소스 또는 드레인 영역을 형성한 후에, 상기 게이트 전극부 표면을 양극산화하고, 그 후에 열처리 공정을 갖는 점을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.
- 청구항 4. 금속이 게이트 전극과 그 게이트 전극을 둘러싸아 형성된 양극 산화층층과, 박막형의 채널영역과, 그 채널영역을 끼워 형성된 한쌍의 제1의 불순물영역과, 각 제1의 불순물영역에 인접한 제2의 불순물영역을 갖는 점을 특징으로 하는 박막형의 절연게이트형 반도체장치.
- 청구항 5. 제4항에 있어서, 제1의 불순물영역은 비정질 상태인 점을 특징으로 하는 절연게이트형 반도체장치.
- 청구항 6. 제1항에 있어서, 그 반도체장치 절연기판상에 형성되고, 그 소스 혹은 드레인의 어느 한쪽은 커패시터 소자에 접속되어 있는 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 7. 제6항에 있어서, 그 반도체장치는 액정 표시장치 화소의 구동에 이용되는 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 8. 제4항에 있어서, 그 반도체장치는 절연기판상에 형성되고, 그 소스 혹은 드레인의 어느 한쪽은 커패시터 소자에 접속되어 있는 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 9. 1개의 기판상에 형성된 제1 및 제2의 MIS형 트랜지스터를 갖는 반도체장치에 있어서, 제1의 MIS형 트랜지스터의 게이트 전극의 측면 및/또는 윗면에 존재하는 게이트 전극을 구성하는 재료의 산화물로 이루어진 물체의 두께가 제2의 MIS형 트랜지스터의 것과 서로다른 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 10. 제9항에 있어서, 반도체장치는 액티브 매트릭스형의 액정표시 장치인 점을 특징으로 한다.
- 청구항 11. 1개의 기판상에서 적어도 하나의 MIS형 트랜지스터와, 상기 MIS형 트랜지스터의 게이트 전극과 같은 층내에 적어도 하나의 제1의 배선과, 상기 제1의 배선과는 서로다른 층내에 존재하는 제2의 배선이 존재하고, 또한, 상기 제1 및 제2의 배선이 교점 A에서 교차하고 있는 반도체장치에 있어서, 상기 MIS형 트랜지스터의 게이트 전극의 측면 및/또는 윗면에 존재하는 게이트 전극을 구성하는 재료의 산화물로 이루어지는 물체의 두께가, 상기 교점 A에 있어서 상기 제1의 배선의 측면 및/또는 윗면에 존재하는 것과 서로다른 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 12. 1개의 기판상에 형성된 적어도 하나의 커패시터와, 상기 커패시터의 제1의 전극과 같은 층내의 제1의 배선과, 상기 커패시터의 제2의 전극과 같은 층내에 존재하는 제2의 배선이 존재하고, 또한 상기 제1 및 제2의 배선이 커패시터 이외의 교점 B에서도 교차하고 있는 반도체장치에 있어서, 상기 커패시터의 제1의 전극 윗면에 존재하고, 그 제1의 전극을 구성하는 재료의 산화물로 이루어지는 물체의 두께가, 상기 교점 B에 있어서 상기 제1의 배선의 측면 및/또는 윗면에 존재하는 것과 서로다른 점을 특징으로 하는 반도체장치.
- 청구항 13. 기판상에 형성된 제1의 배선에 선택적으로 제1의 마스크재를 형성한 후, 제1의 배선을 산화하는 공정과, 상기 제1의 마스크재의 적어도 일부를 포함하는 영역에 제2의 마스크재를 형성한 후, 제1의 배선을 산화하는 공정과, 상기 제1 및 제2의 마스크재를 제거한 후, 적어도 제1의 마스크재가 형성된 영역의 일부에 제2의 배선을 형성하는 공정을 갖는 점을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.
- 청구항 14. 기판상에 형성되고, 그 표면이 산화된 제1의 배선에 선택적으로 마스크재를 형성한 후, 제1의 배선을 산화하는 공정과, 상기 마스크재를 제거한 후, 적어도 마스크재가 형성된 영역의 일부에 콘택트층을 형성하는 공정과, 상기 콘택트층의 적어도 일부에 제2의 배선을 형성하는 공정을 갖는 점을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.
- 청구항 15. 기판상에 형성되고 그 표면이 산화된 제1의 배선을 선택적으로 에칭한 후, 중간절연층을 형성하는 공정과, 상기 중간절연층에 콘택트층을 형성한 후, 제2의 배선을 형성하는 공정을 갖는 점을 특징으로 하는 반도체장치의 제작방법.
- ※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도 1



도 2



도 3

